(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.[6]
H01L 23/50

(11) 공개번호 특1997-0067819
(43) 공개일자 1997년10월13일

(21) 출원번호 특1996-0052722
(22) 출원일자 1996년11월08일
(30) 우선권주장 96 057898 1996년03월14일 일본(JP)
(71) 출원인 미쓰비시덴키 주식회사 기타오카 다카시
일본국 도쿄도 지요다구 마루노우치 2-2-3
(72) 발명자 가와즈 아키노부
일본국 도쿄도 지요다구 마루노우치 2-2-3 미쓰비시덴키 주식회사 내
(74) 대리인 백남기

*심사청구 : 있음*

# (54) 지지봉 절단방법 및 지지봉 절단장치

*요약*

반도체장치의 지지봉을 레이저 빔에 의해서 절단되는 기술에 관한 것으로, 레이저의 흡수율을 높이는 것에 의해서 절단의 불안정 상태를 피하고 절단후의 후처리를 실행하지 않고 절단정밀도를 향상시키기 위해, 반도체 장치의 지지봉에 레이저를 간헐적으로 조사하고 적어도 레이저가 조사되고 있지 않은 기간 동안 레이저를 흡수하는 분무해서 지지봉에 부착시키는 구성으로 하였다. 이러한 구성으로 하는 것에 의해서, 지지봉에 레이저빔이 조사되는 기간에 있어서 레이저빔의 흡수율을 높게 유지할 수 있고 절단을 안정하게 할 수 있게 된다.

*대표도*

*도1*

*명세서*

[발명의 명칭]

지지봉 절단방법 및 지지봉 절단장치

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명의 실시형태1에 따른 구성을 도시한 모식도.

본 건은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

*(57) 청구의 범위*

**청구항 1**

(a) 반도체장치의 지지봉에 레이저를 간헐적으로 조사하는 공정과 (b) 적어도 상기 레이저가 조사되고 있지 않은 기간동안 상기 레이저를 흡수하는 흡수재를 분무해서 상기 지지봉에 부착시키는 공정을 포함하는 것을 특징으로 하는 지지봉 절단방법.

**청구항 2**

제1항에 있어서, 상기 공정 (b)에 있어서 상기 흡수재는 상기 레이저가 조사되고 있는 기간에도 분무되지 않는 것을 특징으로 하는 지지봉 절단방법.

**청구항 3**

반도체장치의 지지봉에 간헐적으로 조사되는 레이저를 제어하는 레이저장치, 상기 지지봉 상으로 상기 레이저를 흡수하는 흡수재를 분무해서 분무부 및 상기 흡수재를 적어도 상기 레이저가 조사되고 있지 않은 기간동안 공급하는 흡수재 공급제어부를 구비한 것을 특징으로 하는 지지봉 절단장치.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

## 도면

### 도면1

